(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2010 年 3 月 11 日(11.03.2010)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2010/026988 A1

(51) 国際特許分類:
G03F 7/023 (2006.01) *G03F 7/40* (2006.01)
G03F 7/004 (2006.01) *H01L 21/027* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2009/065336

(22) 国際出願日: 2009 年 9 月 2 日(02.09.2009)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2008-227182 2008 年 9 月 4 日(04.09.2008) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化成工業株式会社 **(HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.)** [JP/JP]; 〒1630449 東京都新宿区西新宿二丁目１番１号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 松谷 寛 **(MATSUTANI Hiroshi)** [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目１３番１号 日立化成工業株式会社内 Ibaraki (JP). 上野 巧 **(UENO Takumi)** [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目１３番１号 日立化成工業株式会社内 Ibaraki (JP). ニコラ アレクサンドロ **(NICOLAS Alexandre)** [FR/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目１３番１号 日立化成工業株式会社内 Ibaraki (JP). 七海 憲 **(NANAUMI Ken)** [JP/JP]; 〒3080857 茨城県筑西市小川１４２５番地 日立化成コーテッドサンド株式会社内 Ibaraki (JP).

(74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 **(HASEGAWA Yoshiki** et al.); 〒1040061 東京都中央区銀座一丁目１０番６号銀座ファーストビル 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

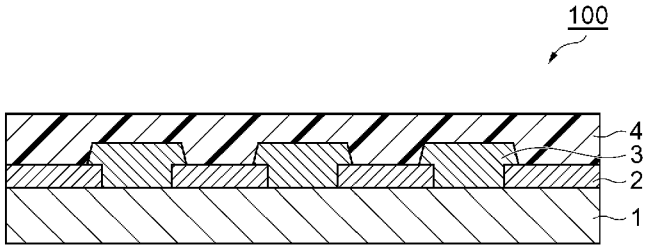
添付公開書類:

— 国際調査報告（条約第 21 条(3)）

(54) Title: POSITIVE-TYPE PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION, METHOD FOR PRODUCING RESIST PATTERN, AND ELECTRONIC COMPONENT

(54) 発明の名称 : ポジ型感光性樹脂組成物、レジストパターンの製造方法及び電子部品

[図1]



(57) Abstract: A positive-type photosensitive resin composition comprising (A) an alkali-soluble resin having a phenolic hydroxy group, (B) a phenolic resin modified with a compound having an unsaturated C_{4-100} hydrocarbon group, (C) a compound capable of producing an acid upon the exposure to light, (D) a thermally cross-linking agent capable of cross-linking between the components (A) and (B) upon heating, and (E) a solvent.

(57) 要約: （Ａ）フェノール性水酸基を有するアルカリ可溶性樹脂と、（Ｂ）炭素数４～１００の不飽和炭化水素基を有する化合物で変性したフェノール樹脂と、（Ｃ）光により酸を生成する化合物と、（Ｄ）加熱により（Ａ）成分及び（Ｂ）成分を架橋する熱架橋剤と、（Ｅ）溶剤とを含有するポジ型感光性樹脂組成物。

WO 2010/026988 A1